【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年7月24日(2024.7.24)

【国際公開番号】WO2023/062842
【出願番号】特願2023-553895(P2023-553895)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｋ　3/00(2006.01)
Ｂ２３Ｋ26/066(2014.01)
Ｂ２３Ｋ26/352(2014.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｋ　3/00　　Ｎ
Ｂ２３Ｋ26/066
Ｂ２３Ｋ26/352

【手続補正書】
【提出日】令和6年4月11日(2024.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
半導体パッケージ基板は、“Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｍｏｏｒｅ”の流れから、システムをワンチップ化したＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　ａ　Ｃｈｉｐ）へと流れが移り、この流れに沿って盛んに開発されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
このような加工方法であれば、基板の被加工領域に亘ってほぼ均一な凹凸加工を精度よく行うことが可能である。そのため、この態様の加工方法であれば、基板の被加工領域に亘って微細な凹凸加工を精度よく行うことができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５４】
図５に示す成形光学系１２は、Ｘ１シリンドリカルレンズ１３、Ｙ１シリンドリカルレンズ１４、Ｘ２シリンドリカルレンズ１５及びＹ２シリンドリカルレンズ１６からなる複数のシリンドリカルレンズと、集光レンズ１７とを具備する。Ｘ１シリンドリカルレンズ１３及びＸ２シリンドリカルレンズ１５は、これらの焦点距離ｆ１の２倍の間隔で配置されている。Ｙ１シリンドリカルレンズ１４及びＹ２シリンドリカルレンズ１６も、図５の下段に示すように、これらの焦点距離の２倍の間隔で配置されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９９

【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９９】
このような加工方法であれば、基板の被加工領域よりも小さい基板照射エリアになるように基板にレーザビームを照射し、基板照射エリアの一部分を重畳させながら、前記基板の被加工領域の表面凹凸加工を行う、即ち重畳照射を行うので、基板の被加工領域に亘ってほぼ均一な凹凸加工を精度よく行うことが可能である。そのため、この態様の加工方法であれば、基板の被加工領域に亘って微細な凹凸加工を精度よく行うことができる。